



产品描述

导热填隙材料可适用于各种应用环境，不因压力变化和温度波动而失效。JONES导热填隙材料以硅树脂为基材，填充导热粒子，导热系数可在1.7-7W/mK范围内任意选择。因其具有良好的弹性，可用于覆盖不平整或不规则的器件表面，充分填充发热器件和散热片或金属外壳之间的空气间隙，使热量有效的传到至散热机构，从而提高器件的运行效率和使用寿命。JONES导热填隙材料具有自粘性，无需背胶，因此不会影响其导热性能。同时也可涂覆特殊涂层，制成单面粘性产品，以便易于操作与装配。

产品特征

- 具有高导热系数
- 具有自粘性，无需背胶
- 满足RoHS要求
- 211系列产品特点为适用于需要较高硬度的使用领域
- 212 系列产品特点为不同导热系数下表现较低热阻
- 218系列产品特点在于在低压力下可达50%的压缩型变
- 所有导热填隙材料均可根据需要特殊处理，
- 玻纤增强产品标注为F，单面粘性产品标注为A

典型应用

- 机箱或相关组件散热模块
- 内存模块
- 主机和小型办公室网络设备
- 大型存储设备
- 汽车电子设备
- 电信设备
- 无线电设备
- LED照明
- 电源
- LCD和PDP显示器
- 机顶盒
- 视频音频模块
- IT设备

技术参数

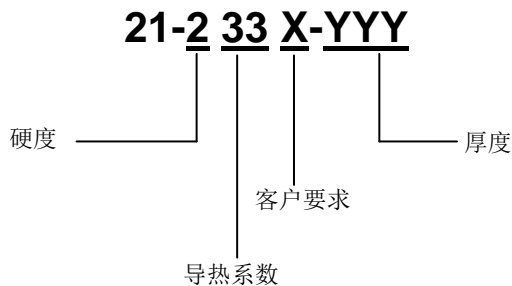
性能		211 S 系列			212 系列				218 系列		测试方法
		21-117	21-132	21-217	21-220	21-232	21-240	21-233	21-830	21-870	
物理特征	颜色	黑色	浅绿色	黑色	浅蓝色	浅绿色	棕色	灰色	浅绿色	灰色	目视
	密度 (g/cc)	2.35	2.62	2.76	2.9	2.99	2.91	2.5	3	2.5	ASTM D792
	标注厚度 (mm)	0.25-5.0							0.5-5.0		ASTM D374
	硬度 (shore 00)	60			40				1	7	ASTM D2240
热性能	导热系数 (W/m.k)	1.7	3.2	1.7	2	3.2	3.8	3	3	7	ASTM D5470
	工作温度 (°C)	-55~200									/
电性能	击穿电压强度 (KV/mm)	>5		1**		>5		>1.5		ASTM D149	
	体积电阻率 (ohm-cm)	>10 ¹³									ASTM D257
	介电常数@ 1MHz	5.85	5.24	4.75	3.8	4.2	3.3	6.14	3.3	4.3	ASTM D150
法规要求	防火等级	UL 94V-0									UL File E309281
	RoHS	Compliant									/
	保质期 (Months)	24									/

订购信息

标准尺寸

16" X 8" (406mmX203mm)

0.25mm 厚度标准产品均为玻纤增强, 标注为F



例如:

21-233-200-0003=导热填隙材料 21-233, 厚度2mm

21-233A-254-0003=导热填隙材料 21-233, 单面粘性, 厚度2.54mm

21-233F-025-0003=导热填隙材料 21-233, 玻纤增强, 厚度0.25mm

联系方式

北京中石伟业科技股份有限公司

公司地址:北京亦庄东环中路三号 100176

电话号码: +86 10 67862636

传真号码: +86 10 67860291

E-mail: sales@jones-corp.com

www.jones-corp.com